

2025 年 10 月 24 日

各 位

会 社 名 岡本硝子株式会社
代表者名 代表取締役会長兼 CEO 岡本 毅
(コード番号 7746 東証スタンダード)
問合せ先 財務経理部長 風間 卓
電 話 04-7137-3111

窒化アルミニウム放熱基板量産製品出荷開始のお知らせ

株式会社 U-MAP（愛知県名古屋市）と協業を進めております窒化アルミニウム放熱基板(下図)につき、量産出荷を開始しましたのでお知らせします。

記

量産出荷を開始しました製品(以下「本製品」)は、5 月にお知らせした量産認定品であり、 $170\text{W/m}\cdot\text{K}$ の熱伝導率を有するセラミックス基板で、レーザーダイオード(LD)や LED チップ等、発光半導体の放熱パッケージ基板として使用されます。

量産第一段の本製品は、主に、高輝度化や小型化の要求が強く放熱が重要となる車載ライティングシステムやスマートフォンのフラッシュライトなどの製品に使用されます。今後、半導体本体においては、今回のような発光半導体から、ロジック半導体へ、さらには、パワー半導体へとその対象を広げ、また、半導体本体のみならず、その部品、さらには、半導体製造装置にもその対象を広げてまいります。

こうして対象製品分野を拡げることにより、半導体基板の全対象市場規 2,000 億円の内 550 億円が当社の狙う高放熱・高強度が要求される市場であり(市場は当社調べ)、2028 年度には約 40 億円の市場獲得を目指します。

今回の量産出荷を皮切りに、今後は熱伝導率を更に向上させた $200\text{W/m}\cdot\text{K}$ 、 $230\text{W/m}\cdot\text{K}$ 製品やそれらを使用した回路基板、さらには、xEV や再生可能エネルギー、生成 AI データーセンターの増大によって市場の急拡大が予測されているパワー半導体市場向けの高放熱・高強度回路基板の量産化を進め、当社製品により生成 AI 時代における熱課題を解決できるよう努めてまいります。



窒化アルミニウム放熱基板